

混装BGA器件高温老化实验焊点微观组织研究

杭春进, 田艳红, 赵鑫, 王春青

哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室, 哈尔滨150001

RESEARCH ON MICROSTRUCTURE OF Pb-FREE BGA SOLDER JOINT ASSEMBLED WITH Sn-Pb SOLDER DURING ISOTHERMAL AGING

HANG Chunjin, TIAN Yanhong, ZHAO Xin, WANG Chunqing

State Key Laboratory of Advanced Welding and Joining, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn